

300mA，低功耗，高压 CMOS 线性稳压器

1 特性

- **RS3015-Q1** 的 **AEC-Q100** 认证正在进行中
- 输入电压范围：**3 V 至 45 V**
- 输出电压范围：
 - 固定选项：**2.5V, 3.3V 和 5.0V**
- 低静态耗电 I_q ：轻载状态下典型耗电 **3 μ A**
- 负载电流高达 **300mA**
- 低压差
- 低温度系数
- 过流保护
- 过温保护
- 输出电压精度： **$\pm 1\%$**
- 封装：**SOT23-5、SOT-223、EMSOP8 和 DFN2X2-6**

2 应用

- 智能电网相关设备
- 电动工具
- **BMS 系统**
- 电机控制系统/工业控制系统
- 仪器仪表
- 白色家电
- 车载系统
- 电池供电系统
- 汽车主机
- 安防设备
- 通讯设备

3 概述

RS3015-Q1 系列是一款采用 CMOS 工艺设计的低压差线性稳压器，具有高达 45V 的输入电压，提供 300mA 的输出电流，非常适合用于多节电池系统、总线电压供电系统、车载电池供电系统和其他高直流电压转低压的应用环境，宽输入电压能使其很好承受浪涌电压的冲击并保证输出电压的稳定。

RS3015-Q1 自身仅消耗 3 μ A（典型值）的电流，这在多节电池供电的系统尤为重要，可以最大程度降低整机系统的待机功耗。

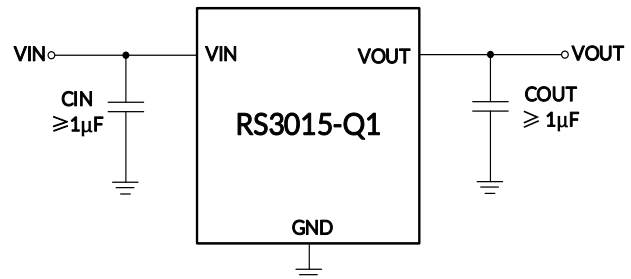
RS3015-Q1 提供 SOT23-5, SOT-223, EMSOP8 和 DFN2X2-6 封装，满足不同应用对耗散功率的要求。

器件信息 ⁽¹⁾

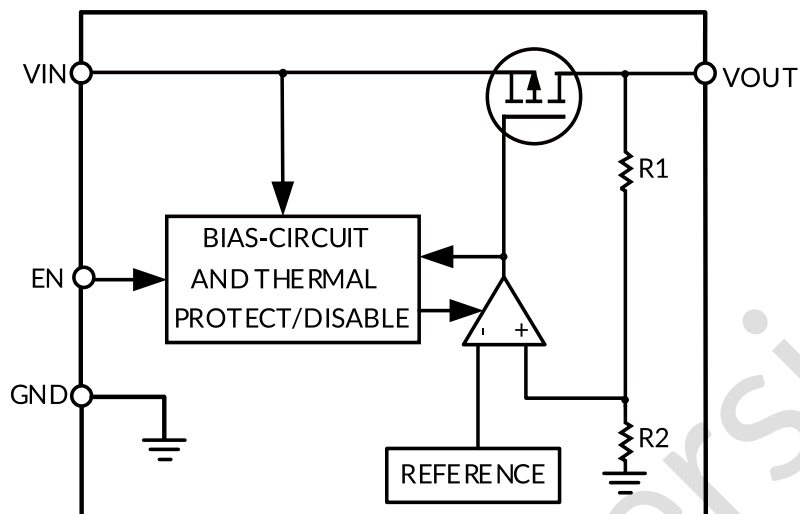
型号	封装	封装尺寸 (标称值)
RS3015-Q1	SOT23-5	1.60mm $\times$ 2.92mm
	SOT-223	3.50mm $\times$ 7.00mm
	EMSOP8	3.00mm $\times$ 3.00mm
	DFN2X2-6	2.00mm $\times$ 2.00mm

(1) 详细的订单型号说明，请参考数据表后的封装选项部分。

4 典型应用电路



5 功能框图



目 录

1 特性	1
2 应用	1
3 概述	1
4 典型应用电路	1
5 功能框图	2
6 修订历史	4
7 封装和订单说明 ⁽¹⁾	5
8 引脚定义和功能（顶视图）	6
9 规格	7
9.1 绝对最大额定参数	7
9.2 ESD 等级	7
9.3 推荐工作条件	8
9.4 典型电气参数	9
9.5 典型参数曲线	11
10 详细说明	17
10.1 概述	17
10.2 欠压锁定 (UVLO)	17
10.3 关断	17
10.4 热过载保护 (T _{SD})	17
10.5 禁用	17
10.6 限流保护	17
10.7 输入和输出电容要求	18
11 电源建议	19
12 PCB 版图设计	19
13 封装规格尺寸	20
14 包装规格尺寸	23

6 修订历史

注意: 更新前的版本页码可能与当前版本不同。

版本	更新日期	变更项目
A.0	2025/08/25	初始版
A.0.1	2025/12/25	1. 更新典型电气参数 2. 增加 DFN2X2-6 和 EMSOP8 封装 3. 删除 SOT23-3、SOT89-3 和 SOT89-3L 封装
A.0.2	2026/07/13	1. 修改 DFN2X2-6 封装规格尺寸 2. 修改 EMSOP8 封装丝印 3. 增加引脚镀层/焊球材料和 MSL 峰值温度信息

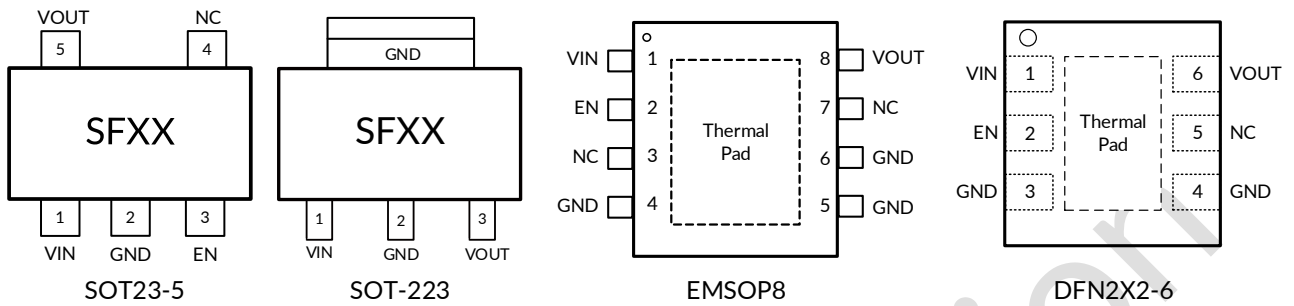
7 封装和订单说明⁽¹⁾

产品名称	订单型号	工作温度(°C)	封装类型	引脚镀层/ 焊球材料 ⁽²⁾	MSL 峰值 温度 ⁽³⁾	丝印 ⁽⁴⁾	包装规格
RS3015-2.5-Q1	RS3015-2.5XF5-Q1	-40°C ~125°C	SOT23-5	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	SF25	Tape and Reel, 3000
	RS3015-2.5XD3-Q1	-40°C ~125°C	SOT-223	Sn	MSL3-260°-Unlimited	SF25	Tape and Reel, 2500
	RS3015-2.5XEM-Q1	-40°C ~125°C	EMSOP8	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	RS3015A	Tape and Reel, 4000
	RS3015-2.5XTDE6-Q1	-40°C ~125°C	DFN2X2-6	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	SF25	Tape and Reel, 3000
RS3015-3.3-Q1	RS3015-3.3XF5-Q1	-40°C ~125°C	SOT23-5	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	SF33	Tape and Reel, 3000
	RS3015-3.3XD3-Q1	-40°C ~125°C	SOT-223	Sn	MSL3-260°-Unlimited	SF33	Tape and Reel, 2500
	RS3015-3.3XEM-Q1	-40°C ~125°C	EMSOP8	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	RS3015B	Tape and Reel, 4000
	RS3015-3.3XTDE6-Q1	-40°C ~125°C	DFN2X2-6	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	SF33	Tape and Reel, 3000
RS3015-5.0-Q1	RS3015-5.0XF5-Q1	-40°C ~125°C	SOT23-5	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	SF50	Tape and Reel, 3000
	RS3015-5.0XD3-Q1	-40°C ~125°C	SOT-223	Sn	MSL3-260°-Unlimited	SF50	Tape and Reel, 2500
	RS3015-5.0XEM-Q1	-40°C ~125°C	EMSOP8	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	RS3015C	Tape and Reel, 4000
	RS3015-5.0XTDE6-Q1	-40°C ~125°C	DFN2X2-6	NiPbAu	MSL1-260°-Unlimited	SF50	Tape and Reel, 3000

注意：

- (1) 该信息是当前版本的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。
- (2) 引脚镀层/焊球材料。可订购器件可能存在多种表面处理选项，各选项间以竖线分隔。若处理工艺名称超出列宽限制，引脚镀层/焊球材料字段将换行显示。
- (3) Runic 装配厂使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键，或者您有特殊要求，请与 Runic 技术支持联系。
- (4) 丝印可能会有其他附加的代码，用于产品的内控追溯（包括数据代码和供应商代码）或者标志产地。

8 引脚定义和功能（顶视图）



注意: **XX** 表示输出电压, **xx** 表示日期代码
例如: **SF33**(V_{OUT}=3.3V)

引脚功能

引脚名称	引脚				功能说明
	SOT23-5	SOT-223	EMSOP8	DFN2X2-6	
GND	2	2	4, 5, 6	3, 4	接地。
VOUT	5	3	8	6	稳压输出端。需在该引脚连接至少 1μF 的低等效串联电阻 (ESR) 电容。
VIN	1	1	1	1	输入电源电压。必须通过1μF或更大电容与 GND 进行就近解耦。
EN	3	/	2	2	使能输入端。电压 <V _{IL} 时关断, >V _{IH} 时启用。未使用时接 VIN, 禁止悬空。
NC	4	/	3, 7	5	无内部连接。
-	/	/	散热焊盘	散热焊盘	将散热焊盘连接至大面积 GND 平面, 以提升热性能。

9 规格

9.1 绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明）^{(1) (2)}

		最小值	最大值	单位
V _{IN}	输入电压范围	-0.3	55	V
V _{EN}	使能脚电压范围	-0.3	V _{IN}	V
V _{OUT}	输出电压范围	-0.3	7	V
T _J	结温 ⁽³⁾	-40	150	°C
P _D	耗散功率 ⁽⁴⁾	由内部热保护温度限制		W
θ _{JA}	结至环境热阻 ⁽⁵⁾	SOT23-5	160	°C/W
		SOT-223	100	
		DFN2X2-6	TBD	
		EMSOP8	TBD	
θ _{JC}	结到外壳（顶部）热阻	SOT23-5	95	°C/W
		SOT-223	70	
		DFN2X2-6	TBD	
		EMSOP8	TBD	
T _{stg}	储存温度范围	-65	150	°C

- (1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。
- (2) 所有电压都与 GND 引脚有关。
- (3) 最大功耗是有关 T_{J (MAX)}、R_{θJA} 和 T_A 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 P_D = (T_{J (MAX)} - T_A) / R_{θJA}。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。
- (4) 内部热关断电路保护设备免受永久性损坏。实际的芯片输出电流受输入输出电压差、环境温度和 PCB 散热设计的影响。
- (5) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。

9.2 ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

		标称值	单位
V _(ESD) 静电放电	人体模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 规范 ⁽¹⁾	TBD	V
	带电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 规范	TBD	V
	闩锁效应 (LU), 符合 AEC Q100-004 规范	TBD	mA

- (1) AEC Q100-002 标准规定，人体模型 (HBM) 静电放电测试须符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范要求。



ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格。

9.3 推荐工作条件

在自然通风温度范围内（除非特别注明）

		最小值	最大值	单位
V _{IN}	VIN 端输入电压范围	3	45	V
V _{EN}	EN 端输入电压范围	0	V _{IN}	V
I _{OUT}	VO _{UT} 端输出电流范围	0	300	mA
C _{OUT}	输出电容范围	1	10	μF
T _A	工作环境温度范围	-40	125	°C
T _J	结温	-40	150	°C

9.4 典型电气参数

测试条件为：工作温度范围为 $(-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq 125^{\circ}\text{C})$, $V_{IN} = V_{OUTnom} + 2V^{(1)}$, $C_{IN} = C_{OUT} = 1\mu\text{F}$, $V_{OUT}=3.3V$, 除非特别注明。

典型值条件为 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 。

参数	符号	测试条件	最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位	
电源电流参数							
输入电压范围 ⁽¹⁾	V _{IN}		3		45	V	
欠压锁定	UVLO	V _{IN} rising	2.05	2.55	2.95	V	
迟滞	V _{HYS}	V _{IN} falling	75	125	200	mV	
静态功耗	I _Q	V _{EN} = 1.7V, I _{OUT} = 0mA		3	12	μA	
待机功耗	I _{SD}	V _{EN} = 0V			1	μA	
输出电压参数							
输出电压范围	V _{OUT}		2.5		5.0	V	
直流输出电压精度 ⁽¹⁾	ΔV _{OUT}	T _J = 25°C, I _{OUT} = 1mA	-1		1	%	
线性调整率 ⁽¹⁾	ΔV _{OUT} (ΔV _{IN})	V _{IN} = V _{OUT} + 2V to 45V, I _{OUT} = 1mA		2	4.5	mV	
负载调整率 ⁽¹⁾	ΔV _{OUT} (ΔI _{OUT})	V _{IN} = V _{OUT} + 2V, I _{OUT} = 1mA to 300mA		20	40	mV	
最大输出电流 ⁽⁴⁾	I _{OUTMAX}		300			mA	
压差参数							
压差 ⁽⁵⁾	V _{DO}	I _{OUT} = 300mA	V _{OUT} = 2.5V		TBD	mV	
			V _{OUT} = 3.3V		1150		2100
			V _{OUT} = 5.0V		1030		2100
电源抑制比和噪声参数							
电源抑制比 ⁽⁶⁾	PSRR	V _{OUT} = 3.3V, I _{OUT} = 10mA	f = 100Hz		60	dB	
			f = 217Hz		60	dB	
			f = 1KHz		58	dB	
			f = 10KHz		53	dB	
			f = 100KHz		45	dB	
输出噪声电压 ⁽⁶⁾	V _N	BW = 10Hz ~ 100KHz, V _{OUT} = 3.3V, I _{OUT} = 300mA		120		μV _{RMS}	
使能和软启动参数							
EN 输入高电平电压	V _{IH}	V _{IN} = 3V to 45V, EN rising	1.7			V	
EN 输入低电平电压	V _{IL}	V _{IN} = 3V to 45V, EN falling			0.4	V	
EN 输入漏电流	I _{EN}	V _{IN} = 45, V _{EN} = 0V		0.01	0.1	μA	
		V _{IN} = 45, V _{EN} = 45V		1.5	3	μA	
保护相关参数							
过流保护阈值	I _{LMT}	V _{IN} = 14V, V _{OUT} = 0.9*V _{OUTnom}	350	550		mA	
热关断阈值 ⁽⁶⁾	T _{TSD}			165		°C	
热关断迟滞 ⁽⁶⁾	T _{HYS}			20		°C	

注意：

- (1) 最小 $V_{IN} = V_{OUT} + V_{DO}$ or 3V, 以较大者为准。
- (2) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保工作温度范围的限制。
- (3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化, 也将取决于应用和配置。
- (4) 最大输出电流受 PCB 布局、金属走线尺寸、金属层间热传导路径、环境温度和系统其他环境因素的影响。应注意当 $V_{IN} < V_{OUT} + V_{DROP}$ 时的压差。
- (5) V_{DROP} FT 测试方法: 在输出电流加载状态下, 在 $V_{SET} + V_{DROPMAX}$ 处测试 V_{OUT} 电压。
- (6) 通过设计与特性验证保证, 非 FT 测试项。

9.5 典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

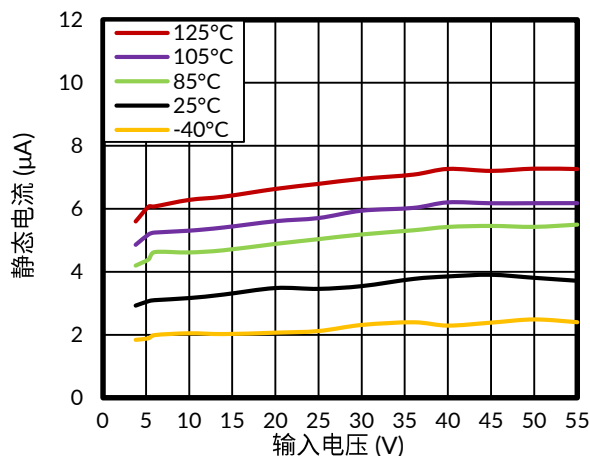


图 1. 静态电流与输入电压的关系

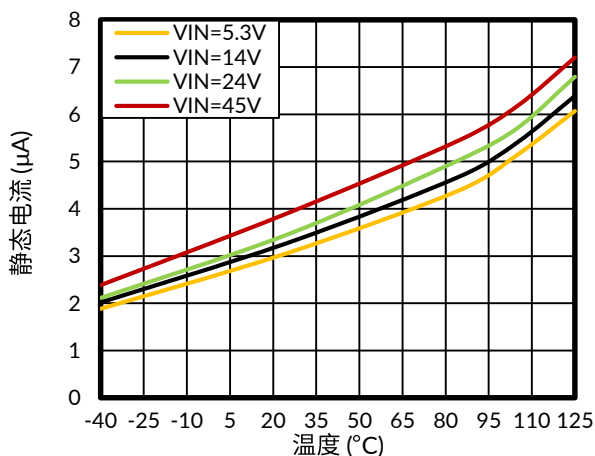


图 2. 静态电流与温度的关系

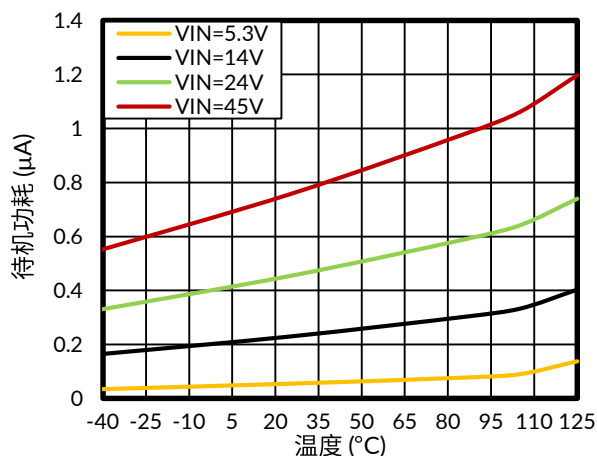


图 3. 待机功耗与温度的关系

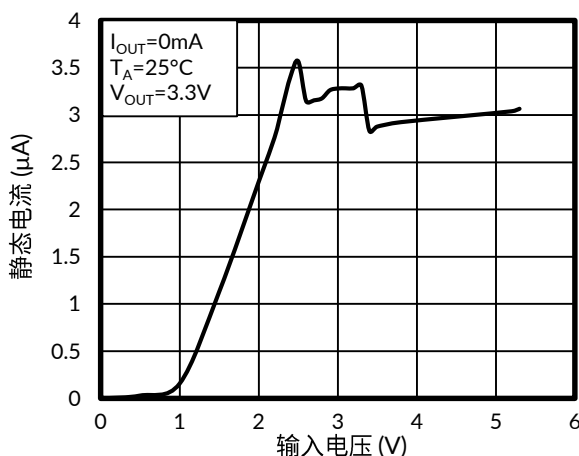


图 4. 静态电流与输入电压的关系

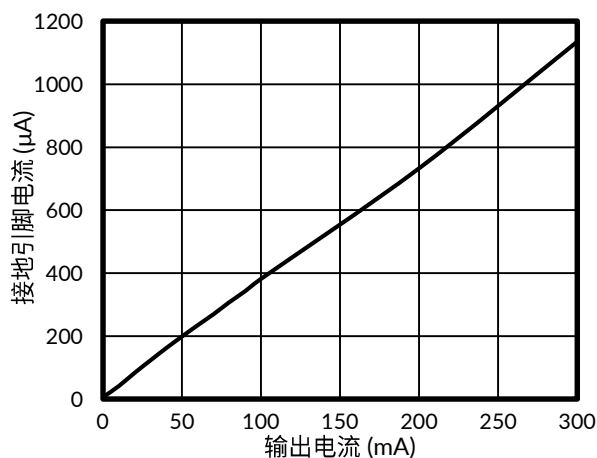


图 5. 接地引脚电流与输出电流的关系

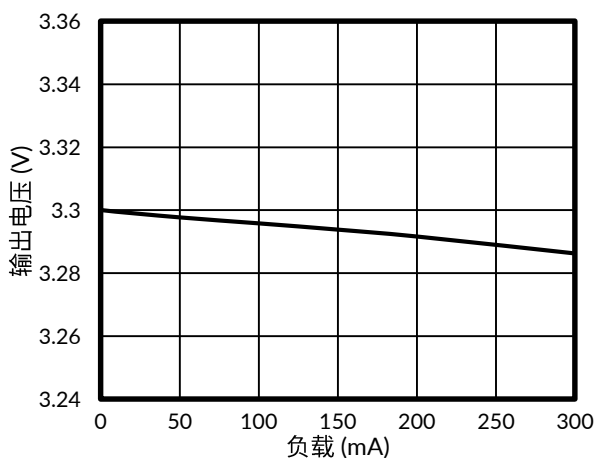


图 6. 负载调整率

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

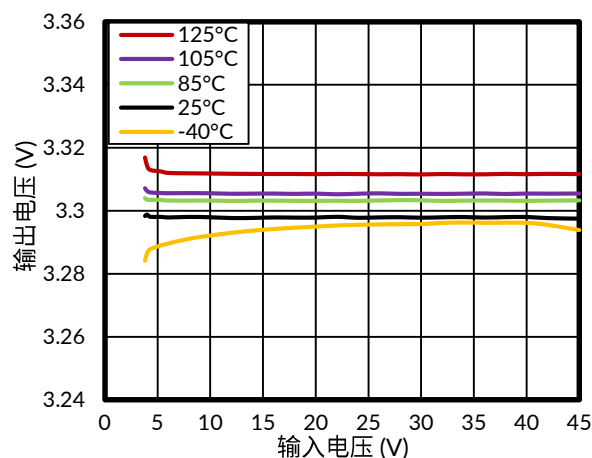


图 7. 线性调整率

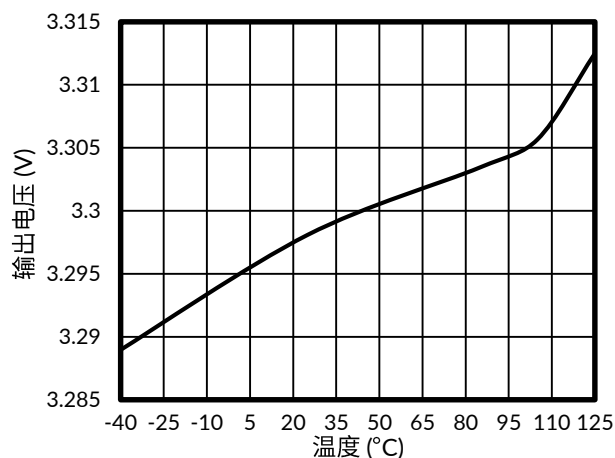


图 8. 输出电压与温度的关系

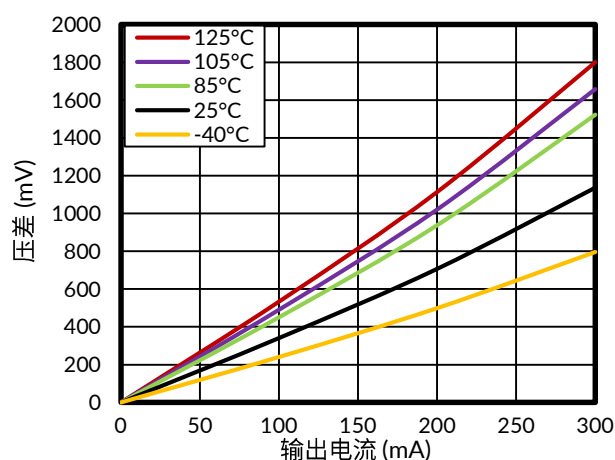


图 9. 压差与输出电流的关系

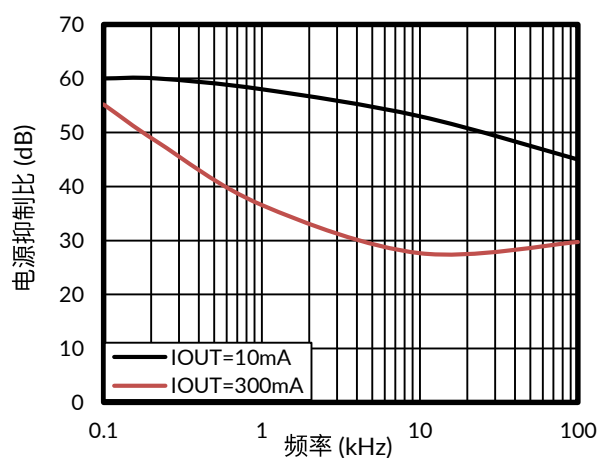


图 10. 电源抑制比与频率的关系

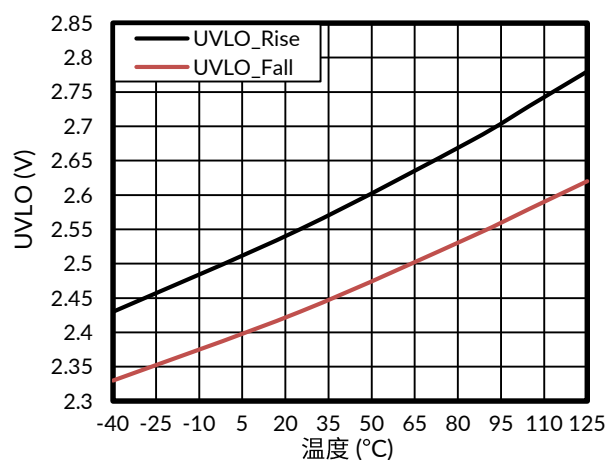


图 11. UVLO 与温度的关系

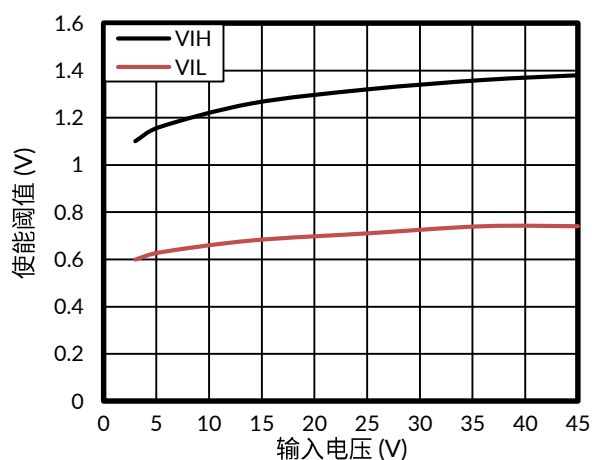


图 12. 使能阈值与输入电压的关系

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

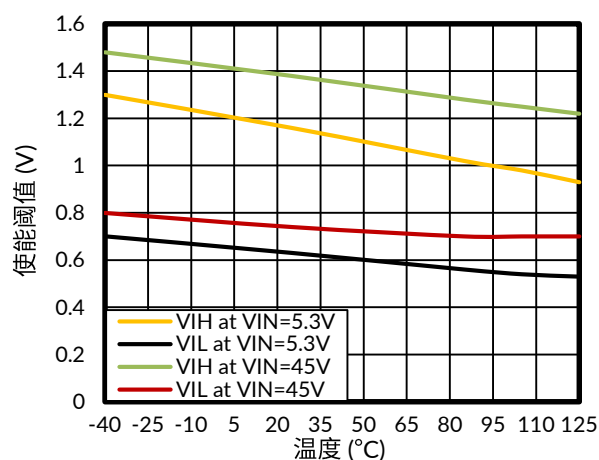


图 13. 使能阈值与温度的关系

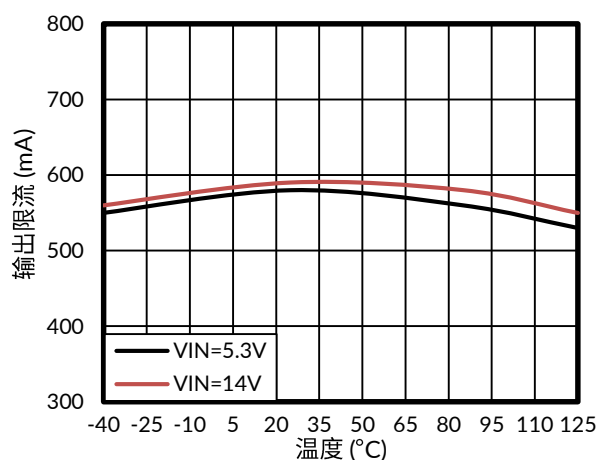


图 14. 输出限流与温度的关系

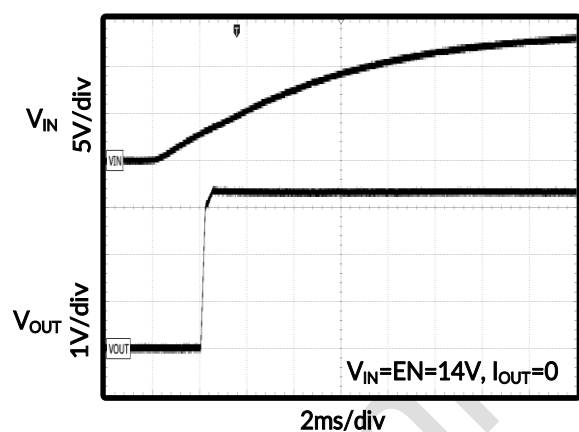


图 15. 上电时序

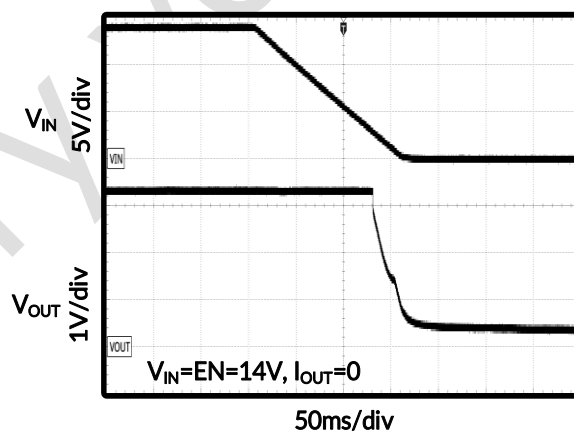


图 16. 下电时序

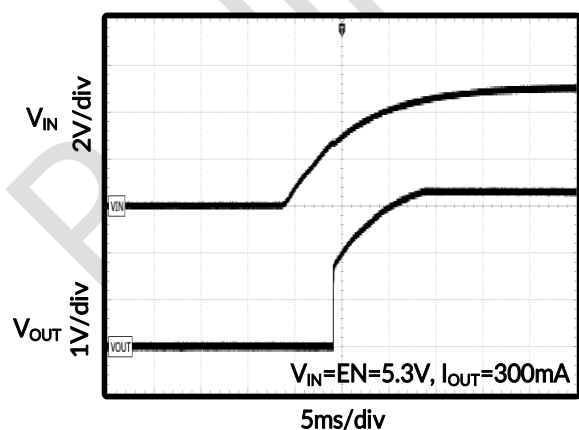


图 17. 上电时序

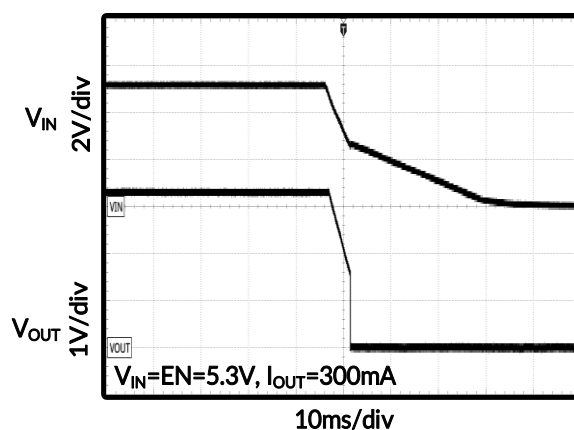


图 18. 下电时序

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

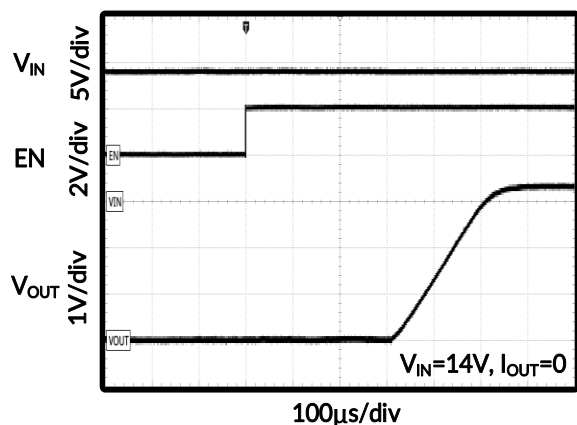


图 19. 开启时序

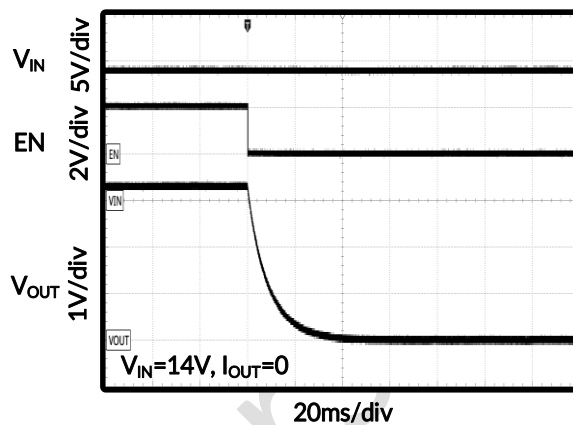


图 20. 关断时序

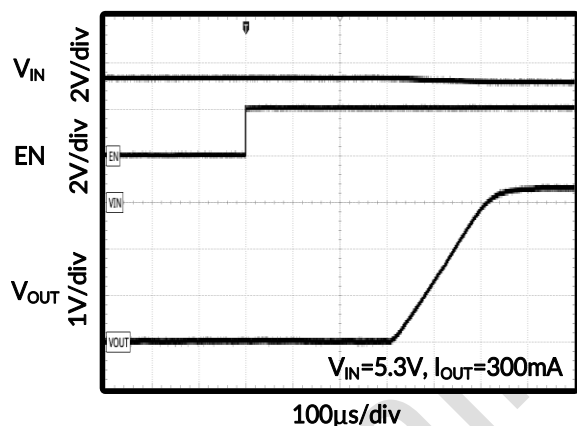


图 21. 开启时序

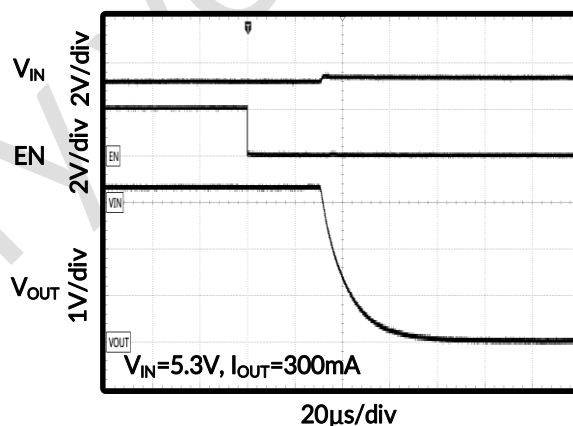


图 22. 关断时序

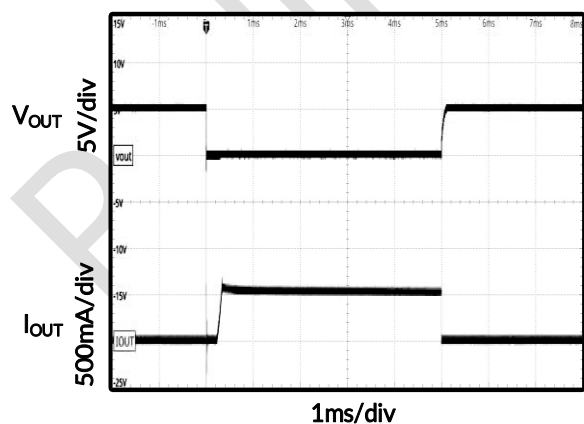


图 23. 先开启后短路时序图

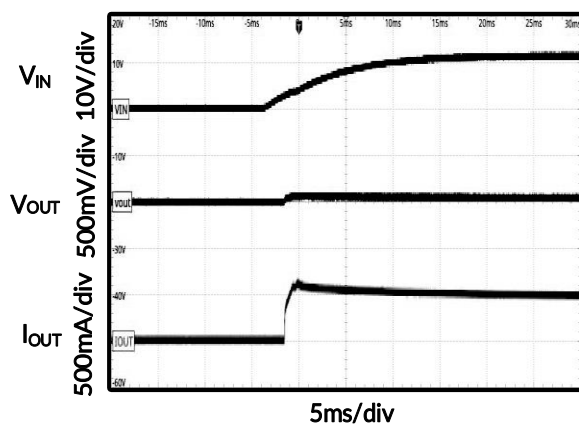


图 24. 先短路后 VIN 开启时序图

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

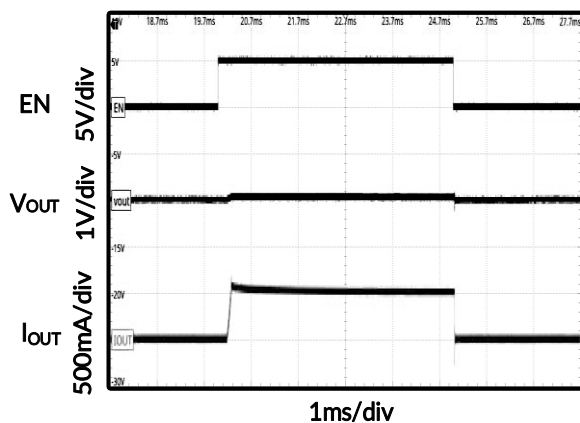


图 25. 先短路后使能输出时序图

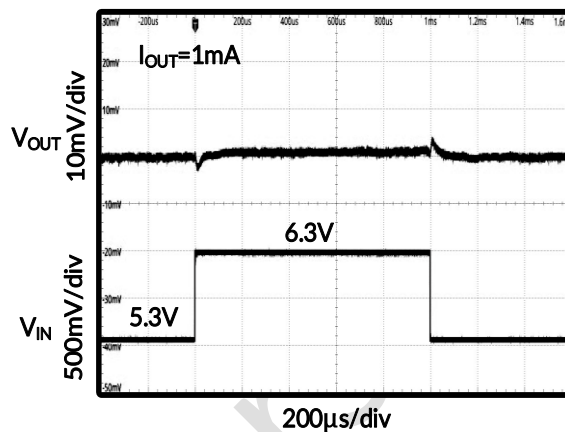


图 26. 线性瞬态响应

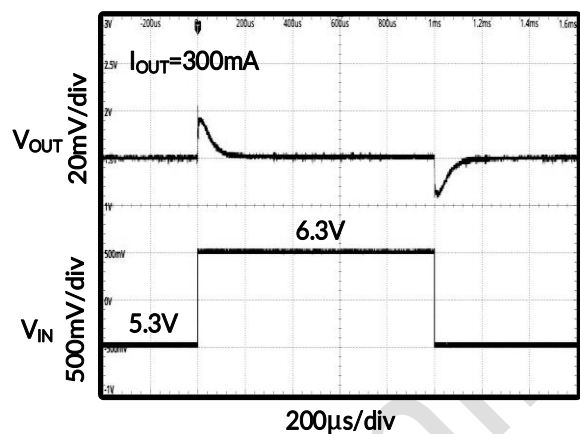


图 27. 线性瞬态响应

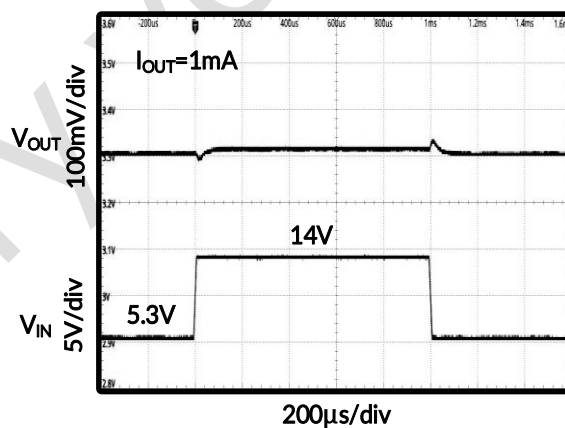


图 28. 线性瞬态响应

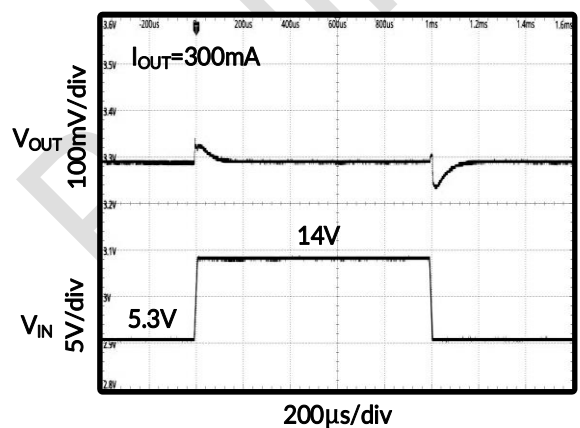


图 29. 线性瞬态响应

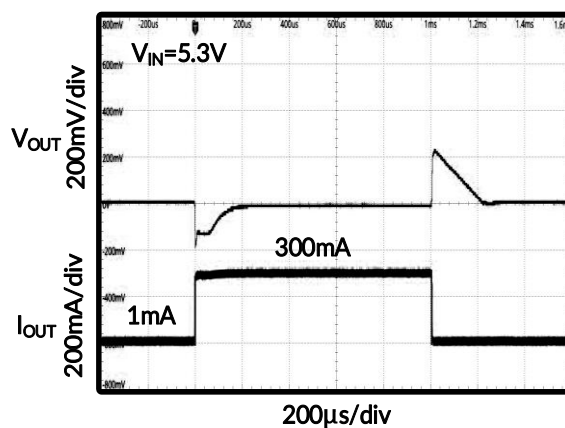


图 30. 负载瞬态响应

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

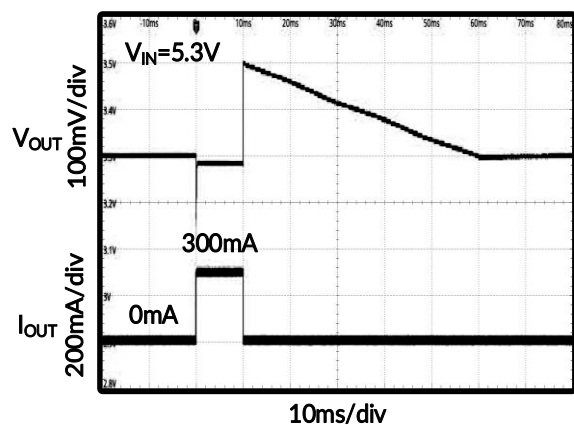


图 31. 负载瞬态响应

10 详细说明

10.1 概述

RS3015-Q1 系列是一款采用 CMOS 工艺设计的低压差线性稳压器，具有高达 45V 的输入电压，提供 300mA 的输出电流，非常适合用于多节电池系统、总线电压供电系统、车载电池供电系统和其他高直流电压转低压的应用环境，宽输入电压能使其很好承受浪涌电压的冲击并保证输出电压的稳定。

RS3015-Q1 自身仅消耗 3 μ A（典型值）的电流，这在多节电池供电的系统尤为重要，可以最大程度降低整机系统的待机功耗。

10.2 欠压锁定 (UVLO)

RS3015-Q1 系列器件采用欠压锁定电路，以便在内部电路正常运行之前保持输出关闭状态。

10.3 关断

使能输入端。电压 $<V_{IL}$ 时关断， $>V_{IH}$ 时启用。未使用时接 VIN，禁止悬空。

10.4 热过载保护 (T_{SD})

当结温升至约 165°C 时，热关断 (T_{SD}) 功能将禁用输出以使器件降温；当结温回落至约 145°C 时，输出电路重新启用。

基于功耗、热阻及环境温度，热保护电路可能周期性启停。此热循环机制可限制稳压器功耗，防止过热损坏。

RS3015-Q1 的热关断电路专为应对瞬时热过载设计，不可替代合理散热方案。若持续触发热关断，可能降低器件可靠性。

10.5 禁用

设备在以下情况下将进入禁用状态：

- 输入电压低于欠压锁定 (UVLO) 阈值减去滞后电压 (V_{HYS})，或尚未达到 UVLO 阈值。
- 使能电压低于使能下降阈值电压，或尚未达到使能上升阈值。
- 器件结温超过热关断温度。

10.6 限流保护

RS3015-Q1 内部电路会监控流经输出 PMOS 功率管的电流，并限制其流过的最大电流，以防止过载，以及芯片在电流过载条件下受损。

10.7 输入和输出电容要求

在靠近稳压器的输入电源端并联一颗 $1\mu\text{F}$ 低等效串联电阻 (ESR) 电容是良好的模拟设计。该电容可抵消输入源的电抗性，改善瞬态响应和纹波抑制。若预期存在大电流、快速上升时间的负载瞬变，或器件距离电源数英寸（远距离布线），则需使用更大容值的电容。

RS3015-Q1 系列器件设计为可使用 $1\mu\text{F}$ 或更大容值的标准陶瓷输出电容稳定工作。X5R- 与 X7R- 型电容为最佳选择，因其容值与 ESR 随温度的变化最小。

Preliminary version

11 电源建议

该器件设计支持 3V 至 45V 的输入电压范围。为了确保设备输出稳定，输入电压范围必须留有足够的余量。输入电源需保持良好稳压特性。若输入电源存在噪声，可使用低 ESR（等效串联电阻）输入电容以改善输出噪声。

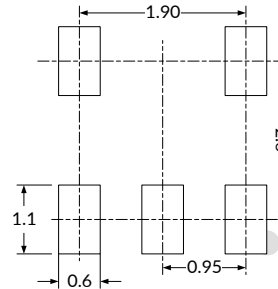
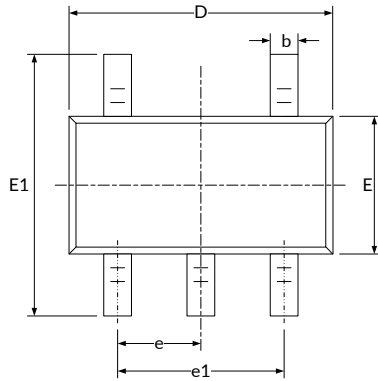
12 PCB 版图设计

为获得最佳整体性能，所有电路元件应布置在 PCB 同一层，并尽可能靠近 LDO 对应引脚。输入/输出电容的接地端与 LDO 接地引脚需通过宽幅表层铜箔就近短接。严禁使用过孔或长走线连接 LDO 外围元件，此类设计将负面影响系统性能。这种接地和布局方案可最小化寄生电感，从而减少负载电流瞬变、降低噪声并提升高电路稳定性。建议增设一个接地参考平面（可内嵌于 PCB 或置于底层），该参考平面有助于确保输出电压的准确性，屏蔽 LDO 免受噪声干扰，并且在连接到裸露散热垫时，其类似于热平面，可扩散（或吸收）LDO 设备的热量。在大多数应用中，这个接地平面是满足热要求所必需的。

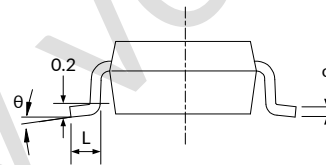
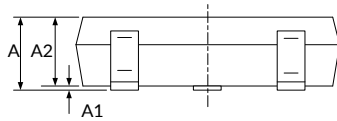
为了提升交流性能（如 PSRR、输出噪声和瞬态响应），建议在电路板上为 V_{IN} 和 V_{OUT} 分别设置独立的接地平面，每个接地平面仅通过设备的 GND 引脚连接。此外，旁路电容的地线必须直接连接到设备的 GND 引脚。

13 封装规格尺寸

SOT23-5⁽³⁾



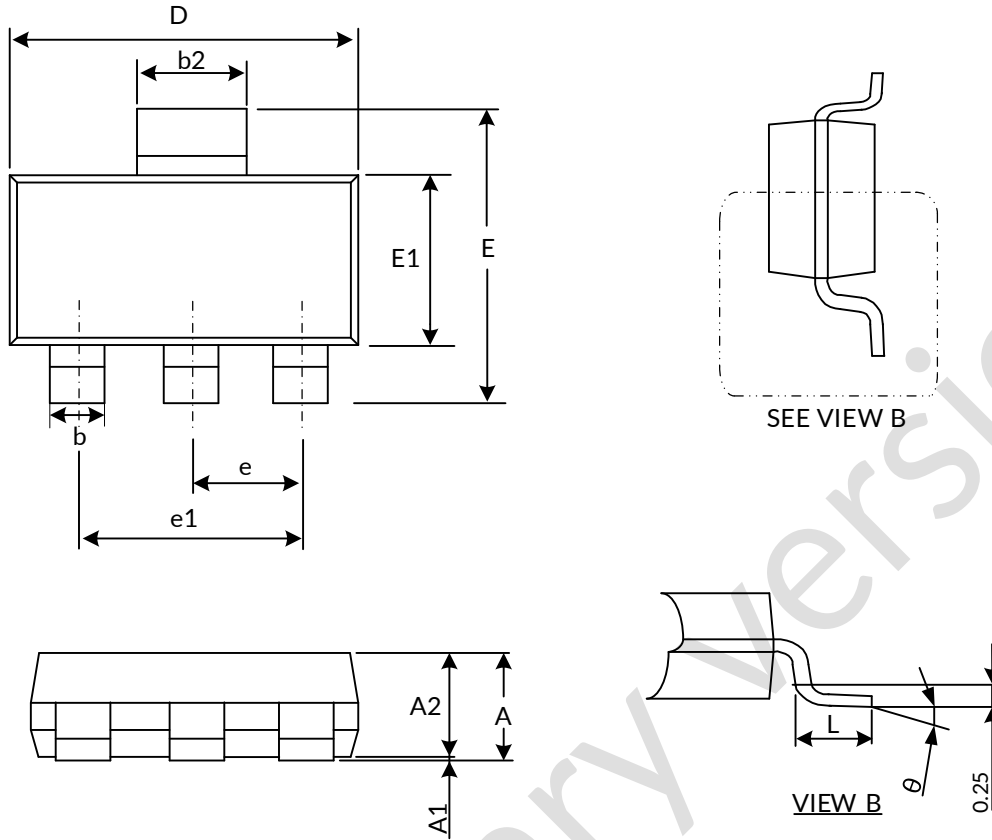
推荐焊盘尺寸 (单位: 毫米)



符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.250		0.049
A1	0.000	0.150	0.000	0.006
A2	1.000	1.200	0.039	0.047
b	0.360	0.500	0.014	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.826	3.026	0.111	0.119
E ⁽¹⁾	1.526	1.726	0.060	0.068
E1	2.600	3.000	0.102	0.118
e	0.950(BSC) ⁽²⁾		0.037(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.350	0.600	0.014	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

注意:

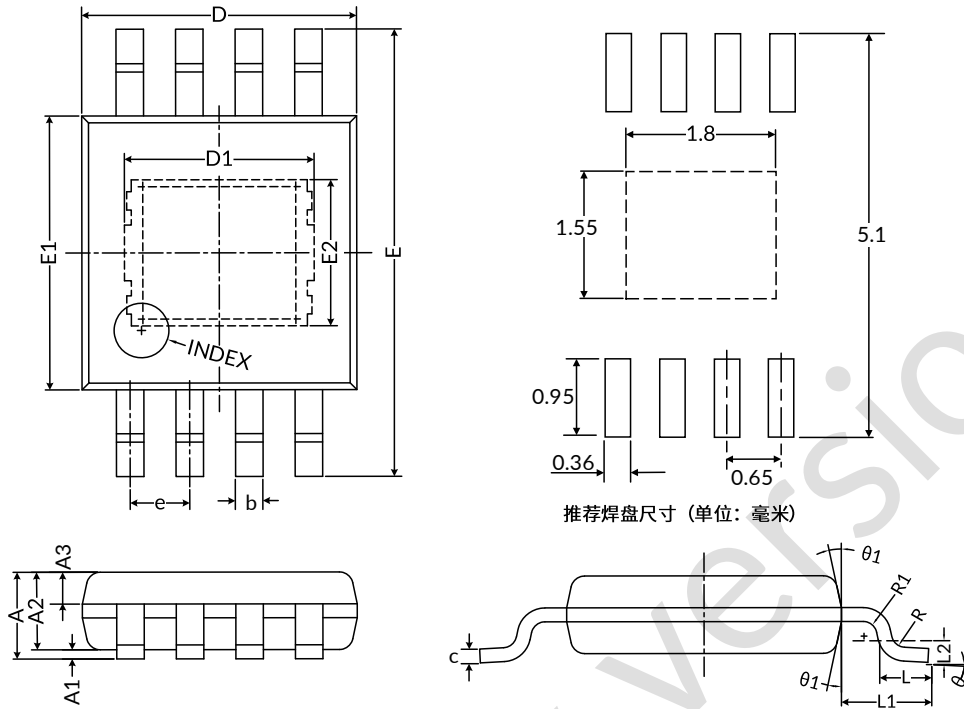
1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑料封料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

SOT-223⁽³⁾


符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	-	1.800	-	0.071
A1	0.02	0.10	0.001	0.004
A2	1.55	1.65	0.061	0.065
b	0.66	0.84	0.026	0.033
b2	2.90	3.10	0.114	0.122
D ⁽¹⁾	6.30	6.70	0.248	0.263
E	6.70	7.30	0.263	0.287
E1 ⁽¹⁾	3.30	3.70	0.130	0.145
e	2.30 BSC ⁽²⁾		0.090 BSC ⁽²⁾	
e1	4.60 BSC ⁽²⁾		0.181 BSC ⁽²⁾	
L	0.90	-	0.035	-

注意:

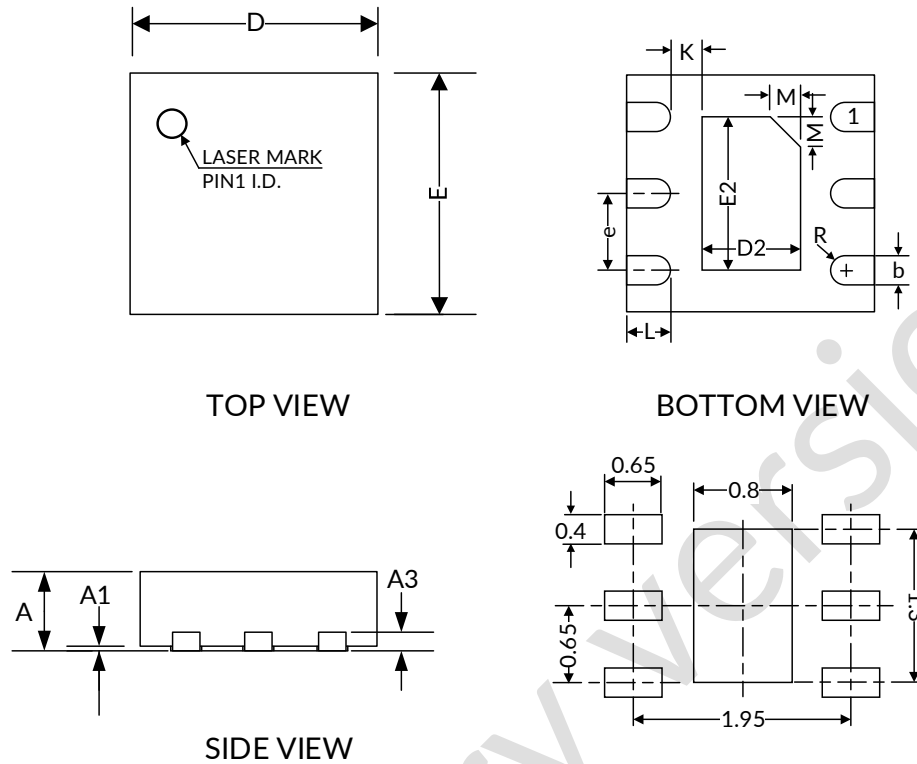
1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

EMSOP8⁽⁴⁾


符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	-	1.100	-	0.043
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
A3	0.300	0.400	0.012	0.016
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.130	0.200	0.005	0.008
D ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
D1	1.920	2.220	0.076	0.087
E	4.750	5.050	0.187	0.199
E1 ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
E2	1.450	1.750	0.057	0.069
e	0.550	0.750	0.022	0.030
L	0.400	0.700	0.016	0.028
L1	0.950 REF ⁽²⁾		0.037 REF ⁽²⁾	
L2	0.250 BSC ⁽³⁾		0.010 BSC ⁽³⁾	
R	0.070	-	0.003	-
R1	0.070	-	0.003	-
θ	0°	8°	0°	8°
θ1	9°	15°	9°	15°

注意:

1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
2. REF 是 Reference 的缩写。
3. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
4. 本图如有更改, 恕不另行通知。

DFN2X2-6⁽³⁾


推荐焊盘尺寸 (单位: 毫米)

符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.700	0.800	0.028	0.032
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.200 REF ⁽²⁾		0.008 REF ⁽²⁾	
b	0.200	0.300	0.008	0.012
D ⁽¹⁾	1.900	2.100	0.075	0.083
E ⁽¹⁾	1.900	2.100	0.075	0.083
D2	0.700	0.900	0.028	0.035
E2	1.200	1.400	0.047	0.055
e	0.550	0.750	0.022	0.030
K	0.150	0.350	0.006	0.014
L	0.300	0.400	0.012	0.016
M	0.250 REF ⁽²⁾		0.010 REF ⁽²⁾	
R	0.130 REF ⁽²⁾		0.005 REF ⁽²⁾	

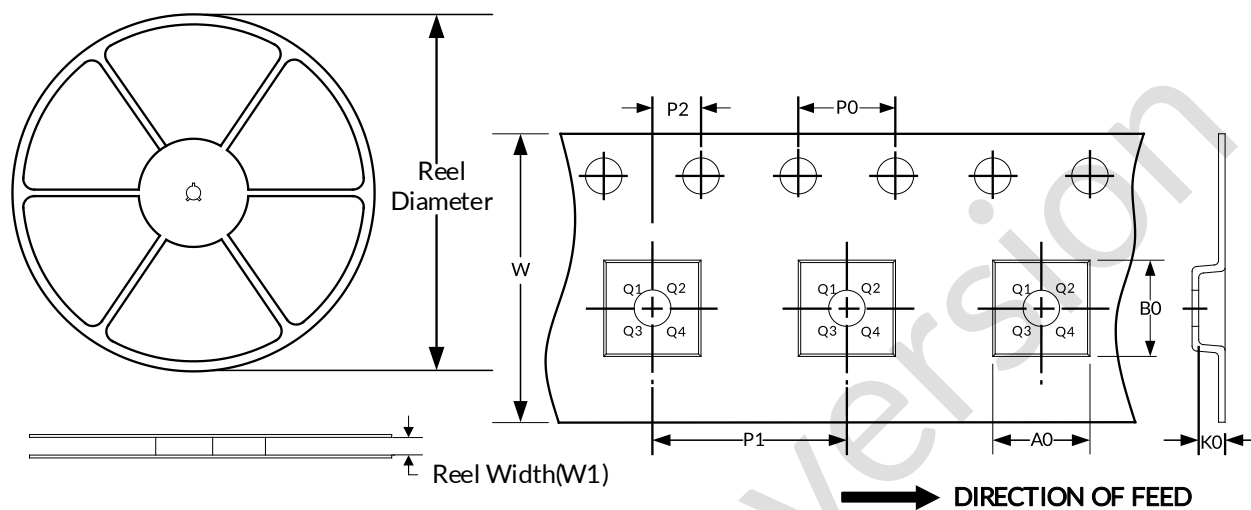
注意:

1. 不包括每侧最大 0.075mm 的塑封料或金属突起。
2. REF 是 Reference 的缩写。
3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

14 包装规格尺寸

卷盘尺寸

编带尺寸



注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOT23-5	7"	9.5	3.20	3.20	1.40	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
SOT-223	13"	12.4	6.765	7.335	1.88	4.0	8.0	2.0	12.0	Q3
EMSOP8	13"	12.4	5.20	3.30	1.50	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
DFN2X2-6	7"	9.5	2.30	2.30	1.10	4.0	4.0	2.0	8.0	Q1

注意：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每边最大 0.15 毫米的塑封料或金属突起。

重要通知及免责声明

江苏 RUNIC 科技有限公司将准确可靠地提供技术和可靠性数据 (包括数据表)、设计资源 (包括参考设计)、应用或其他设计建议、WEB 工具、安全信息等资源, 不保证无任何缺陷, 也不作任何明示或暗示的保证, 包括但不限于适用性保证, 暗示其适用于特定目的的应用。且没有侵犯任何第三方的知识产权。

这些资源适用于使用 RUNIC 产品设计的熟练开发人员, 您将全权负责: (1)为您的应用程序选择合适的产品; (2) 设计、验证和测试您的应用程序; (3) 确保您的应用程序符合适用标准、安全标准或其他要求; (4) RUNIC 及 RUNIC 标识为 RUNIC INCORPORATED 的注册商标。所有商标均为其各自所有者的财产; (5) 对于发生改变的细节, 应查看修订文件中包含的修订历史。资源如有更改, 恕不另行通知。本公司对使用本芯片设计的终端产品的侵犯专利的行为或侵犯第三方知识产权的行为不承担任何连带责任。